Lötpaste SB58-COSMO-NH-T4 DISPENSER

Produktbeschreibung

GENMA Lötpaste – unsere bewährte COSMO Lötpaste gibt es jetzt auch mit niederschmelzender Legierung luftfrei zum Dispensieren. Die Lötpaste SB58-COSMO-NH-T4 ist eine Niedertemperatur-Lötpaste zum Dispensieren. Aufgrund des niedrigen Schmelzpunktes wird die Lötpaste dort eingesetzt, wo ein zweiter Reflow-Lötvorgang notwendig ist, bei sehr temperaturempfindlichen Bauteilen oder zur Einsparung von Energie durch die niedrigere Prozesstemperatur. Die Lötpaste überzeugt durch eine hervorragende Benetzung, hohe Konturenschärfe, lange Standzeit und gleichbleibende Klebekraft beim Bestücken. Die sehr gute Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen sorgt für perfekte Lötstellen. Die außergewöhnlich stabile Viskosität ermöglicht eine Lagerung bis zu 12 Monaten, wodurch sich für Sie die Disposition vereinfacht. Aufgrund der langen Haltbarkeit und Stabilität bei Raumtemperatur ist die Paste auch ideal für die Nacharbeit bei geringem Verbrauch. Unsere SB58-COSMO-NH-T4 ist Vakuum entgast, wodurch sie ein unterbrechungsfreies Dispensieren bei automatisierten Anwendungen gewährleistet.Außerdem kann die Lötpaste ungekühlt transportiert werden. Nach dem Löten ist keine Reinigung notwendig. Die Lötpaste kann unter Luft oder Schutzgas gelötet werden. Die Dispenser-Lötpaste ist in 5cc, 10cc und 30cc Kartuschen erhältlich.

Technische Eigenschaften

	Spezifischer Wert	Testmethode
Legierung (wt %)	Sn 42 / Bi 58	
Schmelzbereich (°C)	138 - 138	IEC61189-11
Pulvergröße (µm)	22 - 38, Typ 4	IPC-TM-650-2.2.14.2
Viskosität (Pas)	180 ± 30	IPC-TM-650-2.4.34.3
Flussmittelgehalt (wt %)	11 ± 0.5	IPC-TM-650-2.3.34.1
Flussmitteltyp	ROL0, no clean	IPC-J-STD-004B
Anwendung Raster (mm)	0,4	
Halogengehalt (%)	<0.01	IPC-TM-650-2.3.35
Verlaufen beim Vorheizen (mm)	≤ 0,3	IPC-TM-650-2.4.35 (120°C / 60sec)
Isolationswiderstand (Ω)	≥ 1 x 10^{11} (40°C 90 % r. L)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Isolationswiderstand (Ω)	≥ 5 x 10^{8} (85°C 85 % r. L)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Migrationstest	Keine Migration	IPC-TM-650-2.6.14.1
Kupferspiegeltest	Keine Korrosion	IPC-TM-650-2.3.32
Verpackungseinheit	Kartusche 5cc, 10cc, 30cc	
Mindesthaltbarkeit	12 Monate bei 0-10°C, 3 Monate bei < 25°C, 1 Monat bei < 35°C	
Transport	Ohne Kühlung	

Konformität

Stand 13.11.2025

Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Anhang 2015/863/EU.

Enthält keine Stoffe (SVHC-Liste) über dem Grenzwert (0,1%) gemäß REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006.

Enthält keine Stoffe gemäß Toxic Substance Conrol Act (TSCA) der United States Environmental Protection

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu

Agency.

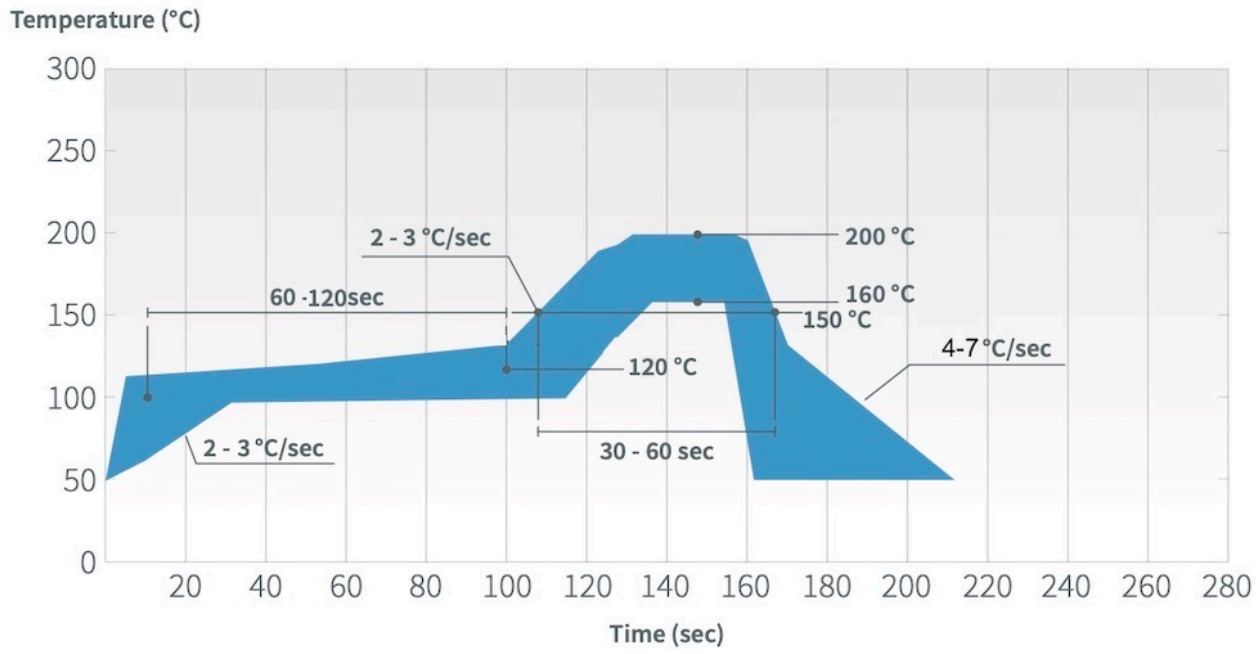
Enthält keine Stoffe gemäß POP Verordnung EU 2019/1021.

Enthält keine per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS).

Enthält keine Phthalate und Latex.

Enthält keine Stoffe gemäß California Proposition 65.

Empfohlenes Reflow Profil



Vorheizen

Der Temperaturanstieg sollte 2 – 3°C / Sekunde betragen. Ein zu schneller Temperaturanstieg kann zum Verlaufen der Lötpaste führen.

Um eine möglichst kleine Temperaturstreuung (⊿t) auf der Leiterplatte zu erreichen, sollte die Temperatur in der Vorheizzone 120 – 150°C und die Vorheizzeit 60 – 120 Sekunden betragen. Im Falle einer niedrigeren Temperatur und kürzerer Zeit ist die Temperaturstreuung (⊿t) auf der Leiterplatte zu groß. Bei zu hoher Temperatur und längerer Zeit gehen die Aktivatoren verloren, was dazu führen kann, dass die Lötpaste nicht aufschmilzt.

Reflow peak

Wir empfehlen, die Temperatur möglichst 20 – 150 Sekunden über 160°C zu halten.

Abkühlung

Die Abkühlgeschwindigkeit sollte zwischen 4 – 7°C / Sekunde betragen. Zu langsames Abkühlen kann dazu führen, dass sich Bauteile verschieben oder aufstellen und die Stärke der Lötverbindungen schwächen. Zu schnelles Abkühlen dagegen kann Bauteile durch thermischen Schock beschädigen.